

# 合肥半导体协会简报

(总第 44 期)

合肥市半导体行业协会

【2020】第 08 期

---

## 国产半导体企业的创新与专利管理研讨会顺利召开

8 月 24 日下午，由合肥市半导体行业协会、合肥芯火双创平台、超凡知识产权服务股份有限公司、合肥高创股份有限公司联合举办的“严保护背景下 国产半导体企业的创新与专利管理研讨会”在合肥高新区顺利举办。

根据企业需求以及企业关注的热点问题。会上，超凡知识产权的相关专家分别就当前国际形势下企业如何防范知识产权风险、半导体行业如何培育高价值专利等内容进行了宣讲，实际列举多例半导体企业风险管控案例、分享半导体企业知识产权挖掘以及检索等实用信息，更好地提升会员企业的知识产权运用和应对能力。

共有会员单位知识产权、专利部等相关人员近 30 人前来参会。

## 协会组织会员企业参展 2020 世界半导体大会

8 月 26 日，2020 世界半导体大会在南京国际博览中心顺利开幕。大会以“开放合作、世界同芯”为主题。

首日高峰论坛和创新峰会中，中国工程院院士、清华大学副校长尤政，南京市委常委、南京市江北新区党工委专职副书记罗群，新思科技中国董事长兼全球资深副总裁葛群，中国电子信息

产业集团有限公司党组成员、副总经理陈锡明、台积电（南京）有限公司总经理罗镇球、中国半导体行业协会副理事长、原清华大学微电子研究所所长魏少军、SEMI 全球副总裁、中国区总裁居龙、英飞凌科技（中国）有限公司副总裁于代辉、长电科技集团总部副总裁包旭升、瑞萨电子集团高级副总裁真冈朋光、芯华章科技创始人、董事长王礼宾、赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂发表分别发表主题演讲。

大会同期举办展览会，设有芯片设计区、晶圆制造区、封装测试区、半导体设备和材料区、政府机构区、产业园区等几大区域。协会组织芯碁微装、芯思原、合肥灿芯、万瑞冷电等会员企业参展了本次大会。

## **国务院印发《新时期促进集成电路产业和 软件产业高质量发展的若干政策》**

近日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。

《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。

《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软

件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。

《若干政策》明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

《若干政策》要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。

## **露笑科技拟在合肥投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园**

露笑科技 8 月 9 日晚间公告称，公司 8 月 8 日与合肥市长丰县人民政府签署了共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园的战略合作框架协议，双方将在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目，包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计 100 亿元。

露笑科技主要从事漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。公司是国内领先的电磁线生产龙头企业，2019 年完成不良资产剥离和顺宇洁能优质发电业务的资产并表，形成“新能源+制造业”双轮驱动的产业布局。

目前，公司正在进行非公开发行，公司拟定增募资投资碳化硅项目，并与中科钢研、国宇中宏达成战略合作。新建碳化硅衬底片产业化项目完成后，公司将形成长晶炉制造与衬底片生产的

完整产业链，初步完成在碳化硅产业的布局，碳化硅衬底片有望成为公司新的业绩增长点。

## 会议预告

9月10日，概论电子技术研讨会将在合肥高新区管委会举行。本次研讨会将与工程师们分享全生态EDA解决方案。

9月14-16日，2020中国半导体材料创新发展大会将在合肥利港喜来登酒店举行。大会将以“新形势、新挑战、新突破”为主题，汇聚集成电路制造、封装测试、设备制造和关键材料等领域的外中企业家和专家学者，开展主题演讲、产业链对接互动、政企专项交流等一系列活动。

9月16日-18日，第23届中国集成电路制造年会暨2020年广州集成电路产业发展论坛将于广州召开。大会将以“赋能制造业、拓展大集群”为主题，开展高峰论坛、专题技术论坛、展览交流等一系列活动。

9月22日，蔚思博检测总部开幕式暨验证分析研讨会将在合肥嘉试顿国际酒店举行。本次研讨会将以“蔚你思量 博你芯动”为主题，将分别进行上午场的行业专家的专题演讲以及下午场的检测开幕式。

---

报：省市相关部门、中国半导体行业协会、中国半导体行业协会集成电路设计分会

送：协会各会员单位、协会个人会员

---

合肥市半导体行业协会

2020年09月05日印发

地址：合肥市高新区天元路2号

电话：0551-65334528

Email: office@hfsia.com